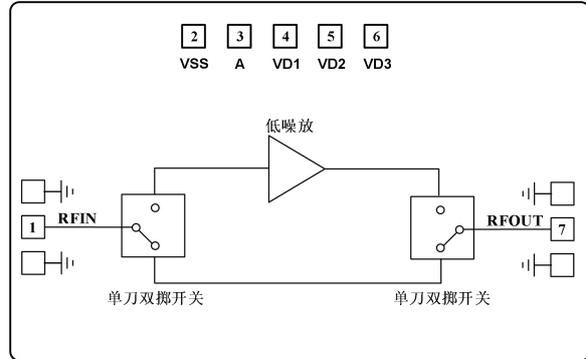




主要特点

- 频段: 3–8.4GHz
- 放大态增益: 24.5 dB
- 放大态噪声系数: 2.5dB
- 放大态输出功率 P1dB: +16.5dBm
- 直通态插入损耗: 1.3dB
- 供电: +5V @ 112 mA, -5V@1mA
- 输入/输出: 50 Ohm 匹配
- 芯片尺寸: 2.5×2× 0.1 mm<sup>3</sup>

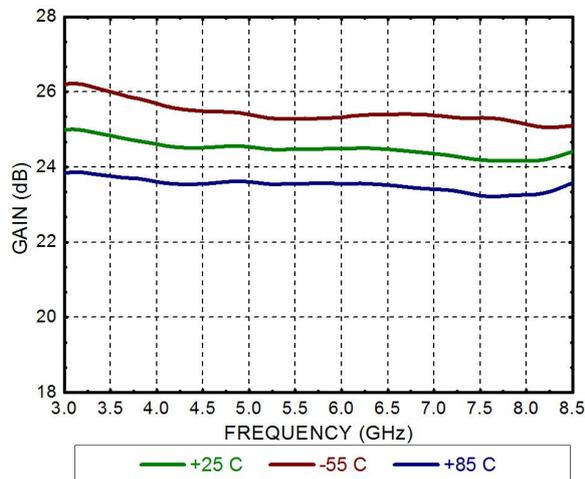
功能框图



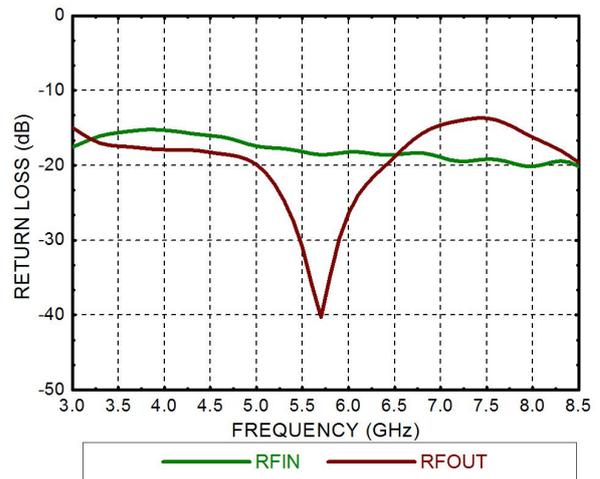
性能指标 ( $T_A = +25^{\circ}C, V_D = +5 V, I_D = 112 mA$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	3–8.4			GHz
放大态增益		24.5		dB
放大态增益平坦度		±0.4		dB
放大态噪声系数		2.5		dB
放大态输出 P1dB		+16.5		dBm
放大态 Psat		+17.5		dBm
放大态输出 IP3		+25		dBm
直通态插入损耗		1.3		dB
输入输出回波损耗		15		dB
工作电流	87	112	127	mA

放大态增益

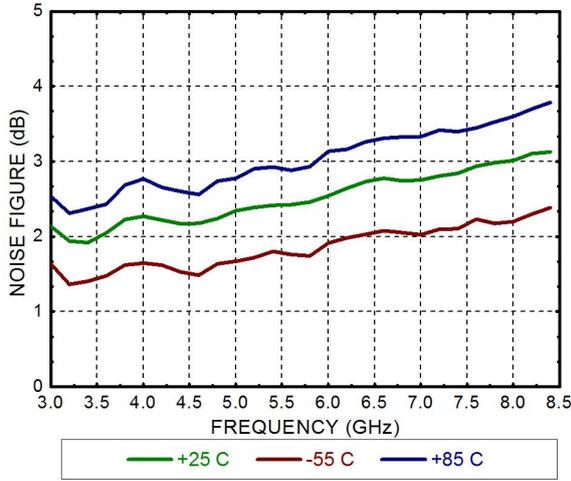


放大态输入输出回波损耗

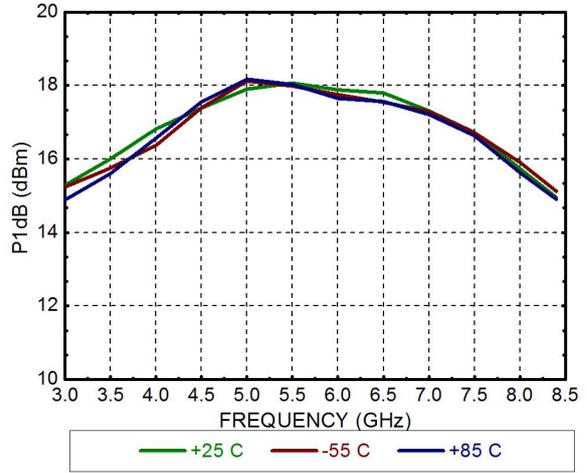




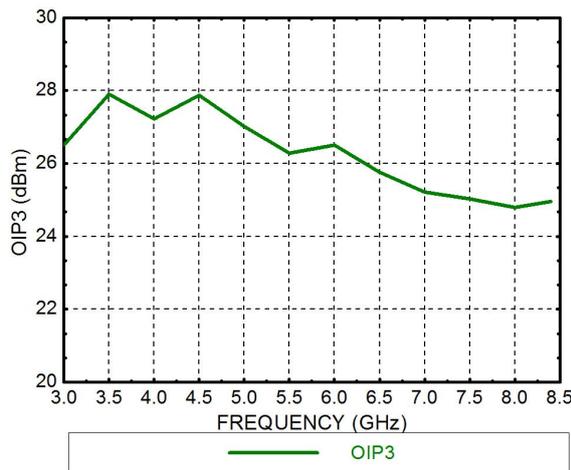
### 放大态噪声系数



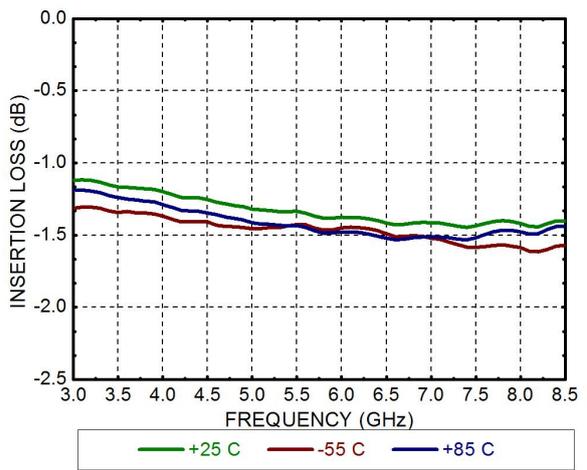
### 放大态输出P1dB



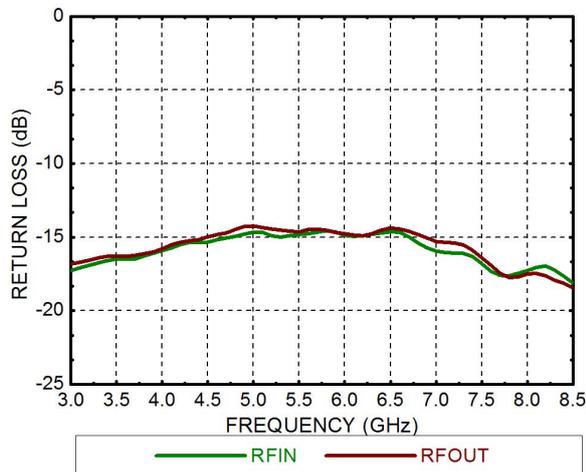
### 放大态输出IP3



### 直通态插入损耗



### 直通态输入输出回波损耗

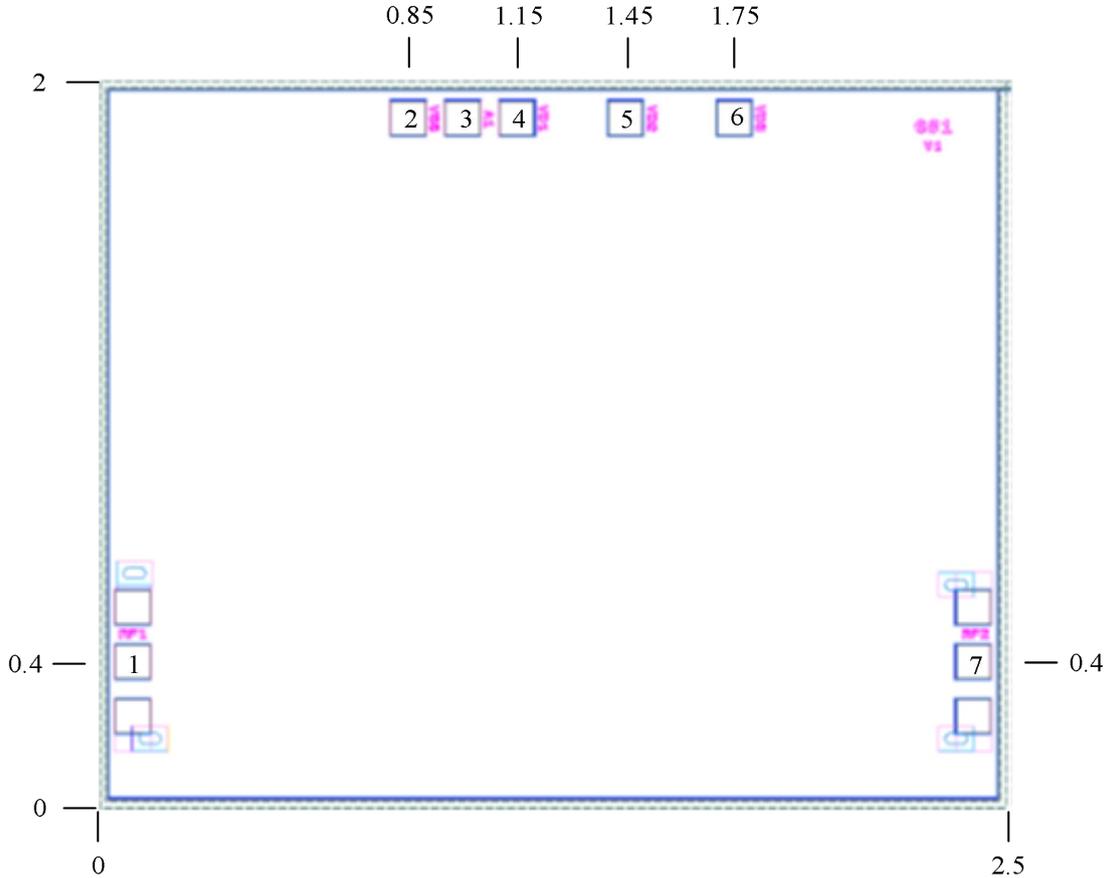




4

放大多功能裸芯片

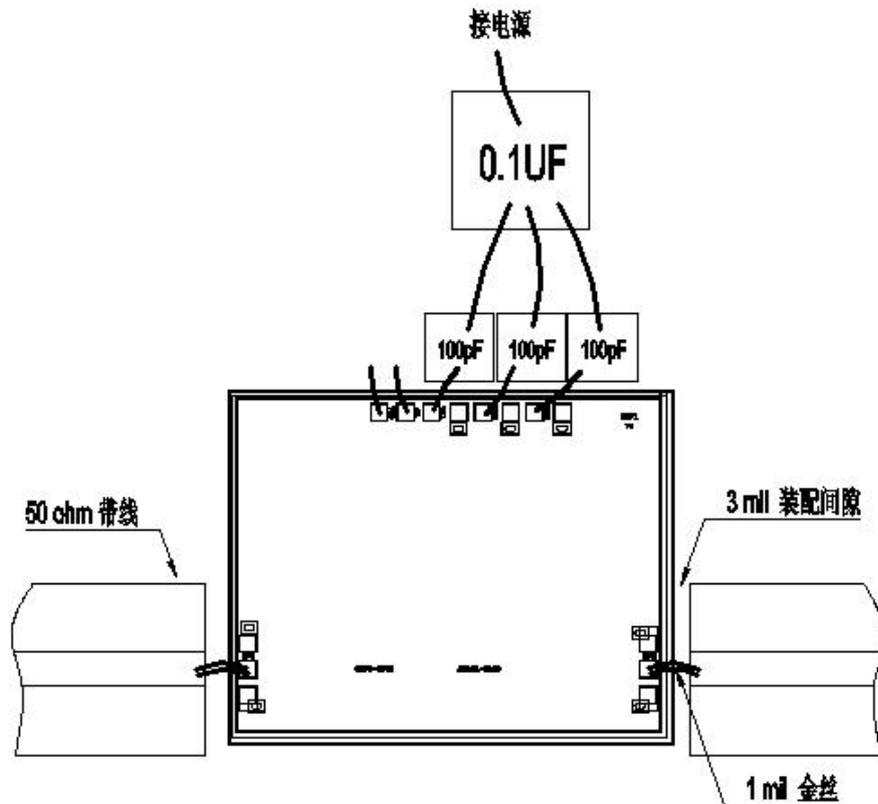
物理参数



焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	RF1	焊盘是射频输入端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
7	RF2	焊盘是射频输出端口, DC 耦合并匹配至 50 Ohm
2	VSS	该焊盘是 TTL 并行控制电源端, 电源电压-5V
3	A1	该焊盘是 TTL 控制电压输入端口, A1=0V 时芯片工作在放大态, A1=+5V 时芯片工作在直通态
4, 5, 6	VD1, VD2, VD3	该焊盘是低噪声放大器供电端口, 需外接 100pF 和 0.01uF 旁路电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

## 装配图



## 注意事项

1. 芯片厚度为 100um
2. 典型键合焊盘尺寸为 100\*100 um<sup>2</sup>
3. 键合焊盘金属化: 金
4. 芯片背面镀金
5. 芯片背面接地
6. 未标注的键合焊盘不需要连接

## 极限参数

1. VD 端口电源电压: +6V
2. VSS 端口电源电压: -5.5V
3. 射频输入功率: +18dBm
4. 储存温度: -65 ~ +175 °C
5. 工作温度: -55 ~ +85 °C